

合同分科会開催のご案内

2022 年度 第 3 回粒子加工技術分科会
(2022 年度 粉体シミュレーション技術利用・粒子加工技術合同分科会)
開催案内および参加募集

主催：(一社)日本粉体工業技術協会
粒子加工技術分科会
コーディネーター 岐阜薬科大学 竹内 洋文
代表幹事 (株)ダルトン 浅井 直親
共催：粉体工学会 製剤と粒子設計部会

拝啓、時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

皆様におかれましては、いつも分科会の活動にご協力頂き、ありがとうございます。

2023 年 3 月 3 日に連続生産をテーマとして粉体シミュレーション技術利用分科会と粒子加工技術分科会の合同分科会を開催します。

粉体シミュレーション技術利用分科会からは、東京大学大学院酒井氏による医薬品製造プロセスにおける粉体シミュレーションについての解説講演をはじめ栗本鐵工所様から粉体プロセス機器事例紹介、パウレック様からシミュレーションを活用した粉体の可視化およびシーメンス様から RTD モデルと RTRT 実装に関してご講演いただきます。

粒子加工技術分科会からは、固形製剤の連続生産による製造承認を取得しているシオノギファーマ様と連続直打システムを製造販売している菊水製作所様より最新の連続生産技術についてご講演いただきます。

開催方式はリモートとし、半日間の講演会となります。粉体技術に関する最新の情報を入手する絶好の機会となります。是非とも参加をご検討ください

【プログラム】

13：00～13：05 開会挨拶

13：05～13：45 講演 1 シオノギファーマの固形製剤連続生産への取り組み

シオノギファーマ株式会社
生産技術部 固形製剤部門長
田中 良介 氏

13：45～14：25 講演 2 直打連続生産システム「CRA-RIS SYSTEM」

株式会社菊水製作所 技術部 設計二課
伏見 伸介 氏

14：25～14：35 休憩

14：35～15：35 講演 3 第 4 次産業革命における医薬品製造プロセスの粉体シミュレーション技術利用

東京大学大学院
工学系研究科レジリエンス工学研究センター 准教授
酒井 幹夫 氏

15 : 35～15 : 55 講演 4 粉体プロセス関連機器及び事例紹介（仮）

株式会社栗本鐵工所
機械システム事業部 粉体プロセス本部
粉体プロセス技術営業部 部長
山崎 晃史 氏

15 : 55～16 : 15 講演 5 連続装置の紹介とシミュレーションを活用した粉体の可視化

株式会社パウレック
研究開発本部 田林 功至 氏

16 : 15～16 : 35 講演 6 連続生産 - RTD モデルと RTRT 実装

シーメンスプロセスシステムエンジニアリング株式会社
シニアアプリケーションズコンサルタント
柏屋 滋 氏

16 : 35～16 : 45 閉会挨拶

16 : 45 閉会

【参加要項】

【日 時】 2023 年 3 月 3 日（金） 13 : 00～16 : 45

【開催形式】 オンライン（Zoom ウェビナー）

【定 員】 50 名 （先着順で定員に達し次第締め切らせていただきます）
1 社からのご参加人数は 3 人までとさせていただきます。

【申込方法】 申込 URL : <https://forms.gle/vZRSkZYUBfigYzHw5>
もしくは下記 QR コードからお申し込みください。



ご注意ください：1 社から複数人がご参加される場合でもお一人ずつお申し込みください。

【申込締切】 2023 年 2 月 20 日（月） （ただし、定員になり次第締め切ります。）

【参加費】（一社）粉体工学会・（一社）日本粉体工業技術協会 会員： 2,000 円
非会員： 3,000 円
大学関係： 1,000 円

請求書は発行致しません。お申込み後に自動返信されるメールに振込先、参加費が記載されています。

お振込時のご留意事項

・個人口座からお振込み： 振込人名を「ご所属・お名前」としてください。

- ・ 一社複数名のお申込： まとめてご入金の場合は、事務局へご一報ください。個々にお手続きされる際は、振込人名を「ご所属・お名前」に変更してください。

【その他】

- ・ 開催 1 週間前に、セミナー参加用 URL をメールでお送りいたします。
- ・ 個別の通信等のトラブルにつきましては、誠に恐れ入りますが対応いたしかねます。
- ・ 今回は ZOOM ウエビナーで開催いたします。当日、開催者側の不手際以外の理由で接続不良があった場合でも返金はいたしません。
- ・ 講演中の撮影、録音、録画は禁止とさせていただきます。
- ・ オンデマンド配信はありません。

【事務局】

粒子加工技術分科会事務局

大川原化工機（株） 小畑さやか

s_obata234@oc-sd.co.jp

以上